

杭州士兰微电子股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料



会议资料目录

- 1、议案之一：关于为控股子公司提供担保的议案 第 3 页

议案之一：

杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的议案

一、担保情况概述

本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）为保证生产经营需要，拓宽融资渠道，拟向金融机构申请授信。本公司在未来 12 个月内拟为士兰集昕向金融机构申请授信提供总额不超过 8 亿元人民币的连带责任担保。

同时公司提请股东大会授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：杭州士兰集昕微电子有限公司
- 2、成立时间：2015 年 11 月 4 日
- 3、注册地址：杭州经济技术开发区 10 号大街（东）308 号 13 幢
- 4、注册资本：82,000 万元
- 5、法定代表人：陈向东
- 6、经营范围：生产、销售：8 英寸集成电路芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）。

7、股东情况：本公司控股子公司杭州集华投资有限公司持有 48.78%，本公司直接持有 2.2%，公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司持有 0.24% 股权，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有 48.78%。

8、截止 2016 年 12 月 31 日，士兰集昕经审计的总资产为 81,312.82 万元，负债 204.53 万元，净资产 81,108.29 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，士兰集昕未经审计的总资产为 76,640.35 万元，负债-4,412.49 万元，净资产 81,052.84 万元。该公司处于建设期，尚无营业收入。

三、公司担保情况

截止 2017 年 3 月 31 日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 4.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形，公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。

本议案已获第六届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，该议案需特别决议通过。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日